CMK

CMK 車載用プリント配線板
CMK Automotive PWB

R&D

貫通ファイン仕様
Fine Through-Hole Specification

Printed Wiring Board
New Technology

http://www.cmk-corp.com

特徴　Feature

- 0.8mmピッチBGAに対してビルドアップ基板から貫通基板への置き換えが可能　（VA/VE 提案）
- エンジンルーム環境にも対応できる高信頼性

- This PWB can have 0.8 mm pitch BGA and can be changed from Build-up PWB. (VA/VE proposal)
- High reliability for automotive engine environment.

用途　Application

- 0.8mmピッチBGAを必要とする車載製品全般（ナビゲーション、メーターパネルからエンジンECUなど）

- Electric products for automotive use which require 0.8 mm BGA spec. (Navigation, meter panel, engine ECU etc.)

構造　Structure

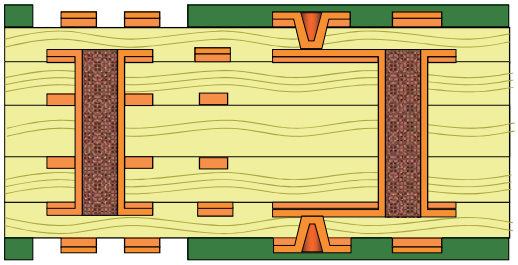
ビルドアップから貫通構造への置き換え可能

Changing from HDI to Through-Hole is possible

0.8mmピッチBGA対応　貫通スルーホール基板

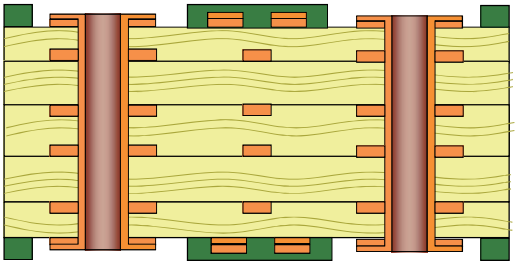
Through-hole PWB with 0.8 mm pitch BGA

ビルドアップ構造

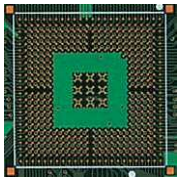


HDI（1－4－1）

貫通構造



Multilayer（6 layer）

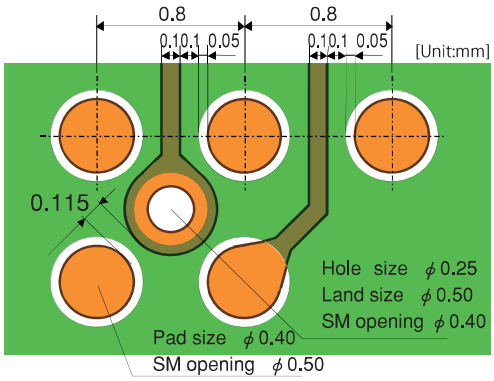


VA/VE 提案

VA/VE Proposal

設計仕様 Design spec.

	仕　様　Specification
基　材 material	弊社指定材 Our specific material
板　厚 PWB thickness	1.2㎜
導体厚 Conductor thickness	32μm (Base Copper 12 + Cu-Plating 20)
L/S（Min.）	0.10/0.10㎜
Land/Hole（Min.）	φ0.5㎜ /Φ0.25㎜

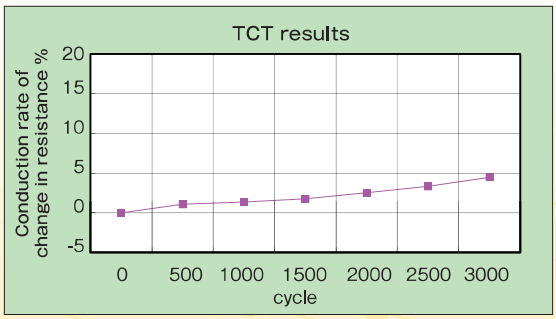


＊Hole size ＝ Drill size

信頼性　Reliability

エンジンルーム環境に適応

Using in engine room climate is possible



〔Through-Hole reliability〕

[Specification]

6layer、PWB thickess 1.6mm（Test only）

Hole size φ0.25mm、Land size φ0.5mm、Cu-plating15μm（Test only）

[Test condition]

-65℃(0.5h)⇔125℃(0.5h)/3000cycle

[Evaluation criteria]

Conduction rate of change in resistance within 10%

2020.01